

## HSDB-6105 型多功能粘片机

适用于平面式 LED 芯片、IC 引线框架、高密度矩阵式引线框架以及分离型的封装(如 TO-92, SOT 等), QFN, PCB, 陶瓷基片等的高速封装。

### 主要技术特点:

1. 全自动上下料
2. 粘片循环周期可达 220 毫秒, UPH 值可达 15000, 效率高
3. 点胶、拾片、放片都采用图像自动对准, 精度高
4. 料条传输机构可调整, 适用于多种材料的封装, 用途广。

### 主要技术指标:

#### 1. 设备相关指标

~循环时间: 最高 UPH 为 14000

循环时间取决于各种因素, 比如 IC 集成电路的互连工艺、芯片尺寸、料条焊盘的布局、必须的粘片精度等。设备在最佳条件下运行, 其 UPH 值最高为 14000。

~粘片精度 X/Y:  $\pm 38\mu\text{m} @3\sigma$

~粘片精度  $\theta$  向:  $\pm 3^\circ @3\sigma$

~粘片时间: 0~1000ms 可控

~粘片压力: 0.3~10N 可控

~良品率: 大于 99%

#### 2. 产品相关指标

##### ◆ 料条

~该设备满足以下料条的芯片粘接: 分立式封装(如 TO-92, SOT...), 红外产品、QFN、PCB、陶瓷、chip LED, 模制引线框架、高密度矩阵式引线框架

~料条长度: 50mm~230mm

~料条宽度: 35mm~80mm; 可调

~料条节距: 取决于料条, 程序可控

~料条厚度:  $80\mu\text{m} \sim 2\text{mm}$ ; 可调

##### ◆ 芯片

~晶圆: 6"

~芯片尺寸:  $0.18 \times 0.18\text{mm} \sim 2 \times 2\text{mm}$

~芯片厚度:  $80\mu\text{m} \sim 300\mu\text{m}$

##### ◆ 粘接胶





---

~银胶或绝缘胶

~胶型及材料：用户或供货商决定

◆ 拾片头

~拾片头的型号及尺寸取决于用户的产品特性。

◆ 点胶头

~点胶头的形状及尺寸取决于用户的产品特性。

◆ 顶针

~顶针的型号及尺寸取决于用户的产品特性。

◆ 可选点胶模块

~点胶控制： 程序控制点胶仪（时间、压力）

~针管容积： 5cc 或 10cc

~点胶针头： 型号及尺寸取决于用户的产品特性。

~点胶时间： 0 ~ 1000ms 可控